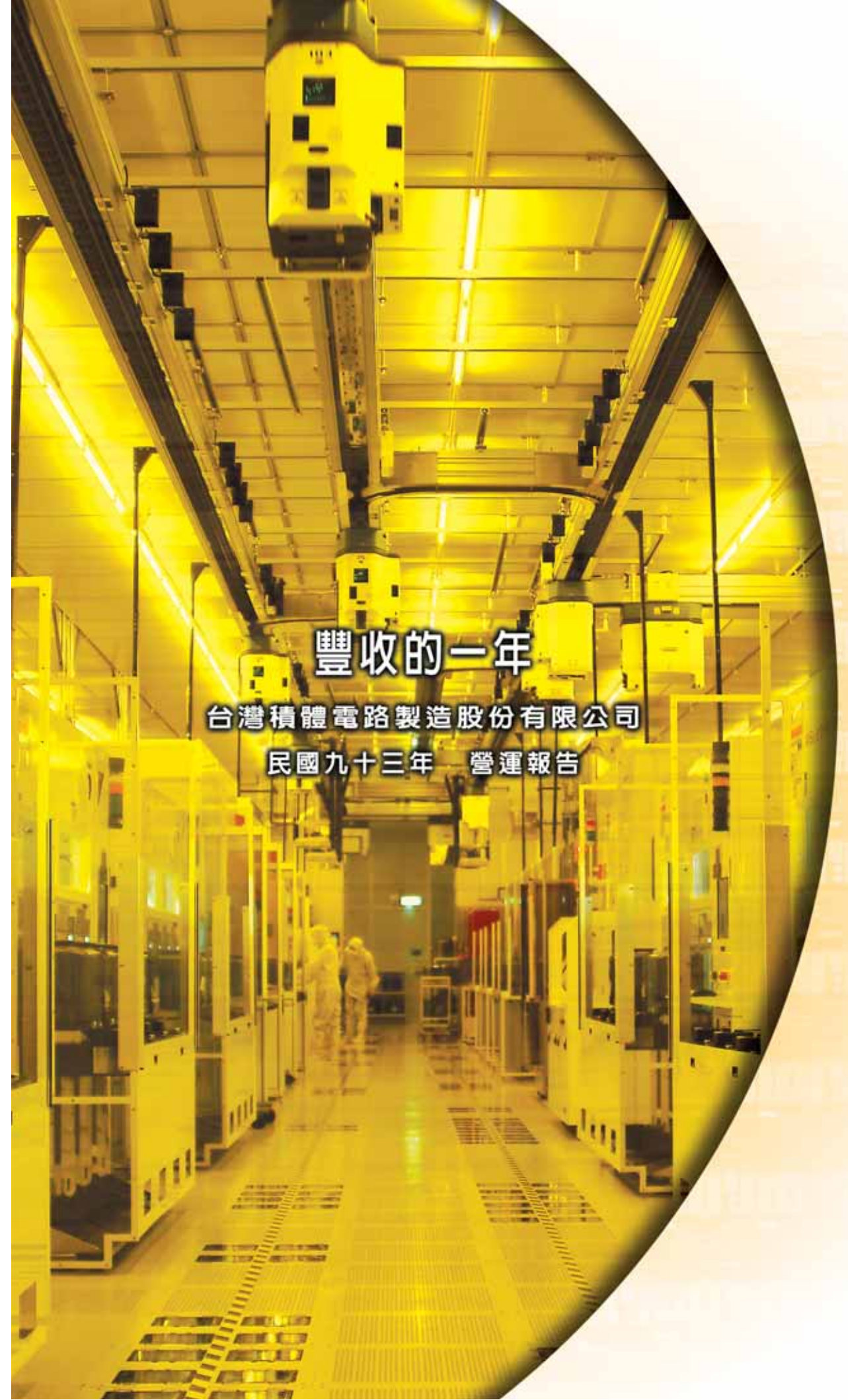




台灣積體電路製造股份有限公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

300-77新竹科學工業園區力行六路8號
8, Li-Hsin Rd. 6, Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan 300-77, R. O. C.
Tel: 886-3-5636688 Fax: 886-3-5637000
<http://www.tsmc.com>



豐收的一年

台灣積體電路製造股份有限公司

民國九十三年 營運報告

目 錄

1	經營理念
3	致股東報告書
6	公司概況
8	市場概況
11	成功的準則
15	公司治理
17	財務概況

經營理念

台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱台積電）在專業積體電路製造服務領域居領導地位，重視承諾，並堅持誠信、正直。

台積電身為業界領導者，在經營策略上反映出全球半導體產業的長期願景，並兼顧客戶的需求。

台積電視客戶為夥伴，客戶從台積電各單位獲得持續的創新及高品質的服務。

台積電致力營造一個有活力、充滿樂趣且同心合作的工作環境，為員工設想，鼓勵創新思維與持續不斷的流程改進。

台積電的經營團隊力求在紮實的營運與財務表現中達到和諧平衡，關懷員工的福利，善盡良好企業公民的責任，以照顧股東的權益。



致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國九十三年是台灣積體電路製造股份有限公司豐收的一年，不但營收與獲利締造新高紀錄，也繼續在全球專業積體電路製造服務領域維持領導地位。而經由本公司所產出的晶片價值，也超過了全球半導體市場的7%。

秉持著「先進技術、生產效率、客戶夥伴關係」三位一體的堅強發展架構，我們在民國九十三年當中，有許多卓越的表現，例如：

- 以0.13微米製程技術為客戶量產累計超過一百萬片八吋晶圓（約當量）積體電路產品。
- 結合了領先業界的十二吋晶圓生產線以及90奈米低介電質、銅導線先進製程技術，在一年內通過量產考驗，為超過三十個客戶產品完成製造服務，產品良率更超出預期水準。
- 總共為超過三百個客戶生產五千多項產品。

我們以製程及運酬管理能力為核心，充分整合前段設計及後段封裝、測試服務，幫助我們的客戶戰勝了許多在先進奈米晶片設計上的艱困挑戰。我們也與客戶保持密切合作，使得客戶的產品能夠快速上市，獲致成功。

財務表現

民國九十三年，台積公司的營收與獲利都創下新高紀錄，全年營收達新台幣2,559億9,000萬元，較前一年成長26.8%；稅後淨利達新台幣923億2,000萬元，較前一年成長95.3%；每股盈餘為新台幣3.97元（換算每單位美國存託憑證之盈餘為0.59美元），年成長率更達到96.8%。若以美元為計算單位，九十三年度的營收為76億5,000萬美元，年成長率30.3%；稅後淨利則為27億6,000萬美元，較前一年成長一倍。

長期的成長引擎

台積公司一貫穩健的財務表現，證明我們擁有堅強且長期成長的實力。我們充分瞭解半導體產業的景氣循環特性，在過去十年中，由於策略運用得宜，再加上謹慎地避免過度投資，我們不但在景氣繁榮時有優異的表現，在景氣低迷的時候也能夠安然度過。事實上，自公司成立迄今十八年當中，我們有十七年都為淨現金流入，這樣的成就是業界少有的。

民國九十三年中，我們不僅首度於上市後發放現金股利（佔總股利的三成）；在十二月二十一日的股東臨時會中更進一步決議，未來股利分派將以現金股利為主，而且股票股利將不高於股利總額的一半。未來，這項政策將有利於我們更彈性地規劃現金股利的發放比率，也再次展現我們認為公司是長期成長引擎的信心。

雙向延伸策略確保未來成長

台積公司從兩個面向來支持獲利的持續成長：在成熟的技術平台上，我們不斷將觸角延伸到更多的特殊應用領域；而在先進製程技術的開發上，則專注於確保在下一代產品應用上的領導地位。藉著特殊製程的提供，我們可以在較老舊、且部分折舊完畢的晶圓廠上，充分發揮卓越的生產規模以及製程能力，以提升其產能利用率，並且延續其獲利能力。另外，有鑒於90奈米製程技術的需求，在民國九十四年中會大幅上揚，我們將持續增加這方面的產能。同一時期內，我們也計畫將先進製程（0.13微米及更先進製程）的總產能擴增一倍以上。

創新

台積公司一直戮力於強化在半導體製程技術上的領導地位，在民國九十三年十二月，我們以ASML公司發展出來的浸潤式微影機台，順利產出全功能90奈米元件，就是一個最佳例證。此項成就的意義，不僅在於它是全球首例，同時也宣告浸潤式微影設備即將臻於量產階段。

優異表現獲致肯定與獎項

過去一年內，我們持續得到來自全球各地的獎項與肯定，在許多國內外媒體（例如：*Institutional Investor*、*The Asset Magazine*、*Asiamoney*、*FinanceAsia*、*IR Magazine*、*The Know Network*）的評比中，我們在營運、知識管理、公司治理、投資人關係等多方面贏得許多獎項；我們也連續八年蟬連天下雜誌的「標竿企業」第一名榮銜。此外，我們也獲頒中華民國經濟部國家發明創作獎之「國家發明貢獻金牌獎」。

其他企業動態

自民國九十三年三月二十四日至五月二十一日止，本公司買回庫藏股計1億2,472萬股，約佔全公司股權的0.6%，這些買回庫藏股隨後於當年第三季自股權中消除。

此外，我們結合轉投資的北美子公司及WaferTech公司，在民國九十二年底到九十三年當中，分別在美國聯邦法院、美國北加州地方法院、以及美國國際貿易委員會，對中芯國際集成電路公司、中芯國際（上海）、中芯國際美國子公司，提出一連串的告訴，控告中芯國際及其子公司侵害本公司多項專利，且不當使用本公司的商業機密。這些訴訟案已於民國九十四年一月底達成和解。依和解協議，中芯國際將在六年內以分期方式支付本公司1億7,500萬美元。

前景與展望

我們認為，全球半導體產業在未來五、六年內，可能將以年成長率8%到10%的速度擴張。就成長幅度而言，全球半導體產業經歷民國九十年最嚴峻的景氣低迷考驗之後，在民國九十二年與九十三年分別展現18%與28%的強勢成長。至於民國九十四年全球半導體產業預期將是零成長，或微幅下降。而單就專業積體電路製造服務領域而言，其在民國九十二年的產出價值佔全球積體電路市場的16%，到民國九十三年時則已增至為18%。我們的雙向延伸策略，伴隨著不斷強化的成本效率及與客戶堅強的夥伴關係，將使本公司在競爭中獲得勝利。

我們深信，經由全體同仁的勤奮努力，和有紀律的營運與財務運作，再加上我們對創新與客戶夥伴關係的堅持，本公司一定能夠繼續保持產業領導者的地位。

張忠謀

張忠謀
董事長暨總執行長

曾繁城

曾繁城
副總執行長

蔡力行

蔡力行
總經理暨營運長



由左至右：曾繁城、張忠謀、蔡力行

公司概況

公司簡介

台積公司是全球領先且規模最大的專業積體電路製造服務公司。在先進製程技術世代，許多公司委外進行生產製造已成為趨勢，當積體電路產業的發展開始進入這樣的新模式時，台積公司無疑是擁有一個絕佳的戰略位置，以及最佳的獲利優勢。

台積公司於民國七十六年二月二十一日在新竹科學工業園區成立，是全球第一家專業積體電路製造服務公司。身為全球的領導者，台積公司提供了業界最先進的製程技術及擁有專業晶圓製造服務領域最完備的元件資料庫（Library）、智財（IP）、設計工具（Design Tools）及設計參考流程（Reference Flow）。

民國九十三年，台積公司及其轉投資、合資公司的總產能，已達全年480萬片八吋晶圓（約當量）。台積公司在台灣設置的廠區計有：

- 一座六吋晶圓廠（晶圓二廠）
- 五座八吋晶圓廠（晶圓三廠、五廠、六廠、七廠及八廠）
- 二座十二吋晶圓廠（晶圓十二廠、十四廠）

此外，台積公司擁有三家轉投資、合資公司的產能配合，包括在美國轉投資的WaferTech公司、在中國大陸轉投資的台積電（上海）有限公司，以及在新加坡成立的合資公司SSMC公司（Systems on Silicon Manufacturing Company）。

創新

持續的創新是台積公司長久以來成功的關鍵。其技術創新的品質，更讓台積公司的研發團隊享有盛名。為進一步強化在研發與技術上的領先地位，台積公司長期致力投資於研究發展，民國九十三年，其研究發展組織人力成長達10.3%，而研發支出則達新台幣125億元，以美金計為3億7,400萬元。

智慧財產是企業維持技術領導地位與自主性的重要關鍵，同時也是交互授權及權利金收益的主要來源。民國九十三年，台積公司共獲頒460件美國專利與516件中華民國專利，更豐富且增強了公司的專利與智慧財產。

台積公司藉由強而有力的前瞻性技術研究，長期維持在半導體業中專業積體電路製造服務領域的領導地位。不僅持續研發後45奈米世代的製程能力，也持續發展諸如尖端的絕緣層上覆矽（SOI）、3D結構、磁阻式隨機存取記憶體（MRAM）、應變矽晶互補式金氧半導體（Strained-layer CMOS），以及新穎的系統單晶片（SoC）等新的電晶體與製程技術。以高度專業的研發團隊加上對創新的承諾，台積公司有信心能延伸摩爾定律（Moore's Law），且深信能提供客戶功能最佳、且最具成本效益的製程技術。

領導

作為市場的領導者，台積公司是最富經驗的專業積體電路製造服務的供應者。公司的資深經理人平均擁有超過二十三年的半導體產業相關專業年資。

台積公司開拓了浸潤式微影技術（Immersion Lithography），並且和光學微影設備商密切合作，以建立此技術的基礎架構及擁有原型測試機台和量產機台。此技術可延續193奈米波長曝光機解析能力至32奈米製程，不需要依賴高風險及高單價的157奈米波長曝光機。

台積公司在公司治理上也是業界卓越的領導者。公司實力堅強的董事會成員，向來皆以維護財務誠信及強化經營管理為職志。九名董事成員中，有三名為獨立董事，他們分別是彼得·邦菲爵士（Sir Peter L. Bonfield）、雷斯特·梭羅教授（Professor Lester C. Thurow）及施振榮先生。邁可·波特教授（Professor Michael E. Porter）則擔任獨立監察人。董事會下設立的稽核委員會以及薪酬委員會均以獨立董事為主要成員。

獲獎記錄

台積公司民國九十三年榮獲獎項如下：

- 台灣最佳聲望標竿企業（連續第八年獲獎）〔天下雜誌，九十三年十月〕
- 台灣最佳管理企業、最佳公司治理、最佳投資人關係〔亞洲財金雜誌（FinanceAsia），九十三年四月〕
- 半導體暨半導體設備科技領域中最佳投資人關係、投資人票選台灣最佳投資人關係〔投資人機構雜誌（Institutional Investor），九十三年七月〕
- 台灣最佳投資人關係〔投資人關係雜誌（IR Magazine），九十三年十一月〕
- 台灣最佳公司治理〔財資雜誌（The Asset Magazine），九十三年〕
- 台灣最佳公司治理〔亞洲貨幣雜誌（Asiamoney），九十三年〕

市場概況

台積公司持續締造卓越表現

一直以來，全球半導體業界不斷致力於開發更先進的製程技術。隨著銅製程以及低介電質（Low-k）製程技術的導入，半導體製程技術的發展開啓了革命性的一頁，也因此半導體元件的面積得以大幅縮小、執行速度大幅增加。

在先進半導體製程技術方面，台積公司已居業界領導地位。台積公司民國九十三年總營收中，有28%來自0.13微米及以下的先進製程技術的貢獻。此外，台積公司領先業界成功使用0.13微米氟矽玻璃介電質（FSG）和低介電質製程技術，為客戶量產多種產品。在民國九十三年，台積公司0.13微米製程出貨量超過一百萬片八吋晶圓（約當量）。此外，以0.13微米及90奈米製程製造的低介電質產品，出貨量也達到12萬片八吋晶圓（約當量）。

台積公司成功推出了先進製程技術的設計參考流程（Reference Flow）以及測試方案，以協助客戶以先進製程技術進行產品設計，再加上完備的智財（IP）及元件資料庫（Library），更有助於協助客戶降低產品設計的成本、提高產品設計的成功製造率以及加速產品上市的時程。

此外，台積公司不斷致力於研究發展並專注於客戶服務，這也是台積公司能夠在民國九十三年持續締造卓越表現的重要原因。

市場分析

全球積體電路產業延續民國九十二年16%的年成長率，民國九十三年產值成長到美金1,790億元，年成長率達28%。至於全球半導體業的產值則達到美金2,130億元規模。其中無晶圓廠積體電路設計公司在民國九十三年產值成長率略為超過半導體整合元件製造商，佔全球積體電路產業的比率達15.5%。而同時為無晶圓廠積體電路設計公司和半導體整合元件製造商提供製造服務的積體電路製造服務產業，民國九十三年之營收比前一年成長40%，達美金199億元。其中的專業積體電路製造服務公司之營收在民國九十三年為美金163億元，年成長率達46%。根據市場預估，民國九十三年專業積體電路製造服務公司的產出價值佔全球積體電路產業產值的比重約有18.8%。

另外，根據市場調查公司*IC Insights*的報告，全球專業積體電路製造服務領域的最大市場係屬北美市場，佔九十三年全球市場的58%；第二大市場為亞太地區，佔24%；歐洲市場佔10%及日本市場佔8%。

產業成長預估

在連續二年的高度成長後，業界普遍認為，基於庫存調整和平均晶片價格下跌的原因，全球半導體產業在民國九十四年的產值會和前一年相當或微幅下降，至於民國九十五年則又會恢復成長。

專業積體電路製造服務市場的未來展望：機會與挑戰

台積公司深信，由於積體電路產業對專業積體電路製造服務的依存度日增，專業積體電路製造服務的重要性也將與日俱增。產業分析師預估，專業積體電路製造服務領域的產值佔全球積體電路產業產值的比重，將會由民國九十三年年的18.8%上升到民國九十八年的28.8%。

植基於對未來市場的信心，台積公司目前計劃繼續擴充產能，民國九十四年的資本支出約在美金25億到27億之間，除繼續擴充二座十二吋晶圓廠（晶圓十二廠及晶圓十四廠）的產能外，在中國大陸轉投資的台積電（上海）有限公司的八吋晶圓廠也將加入產能擴充行列。

然而，產能過剩及平均單價下滑所帶來的挑戰仍有可能會在未來數年後出現，因此，我們將繼續致力於開發具有高度成長的市場，以把握成長機會、提高競爭力並降低風險。

一直以來，台積公司不斷致力於提供客戶領先業界的先進製程技術和服務，以期滿足客戶的需求並提高其競爭力。民國九十三年，台積公司提供客戶包括下列多樣完備的先進製程技術和服務：

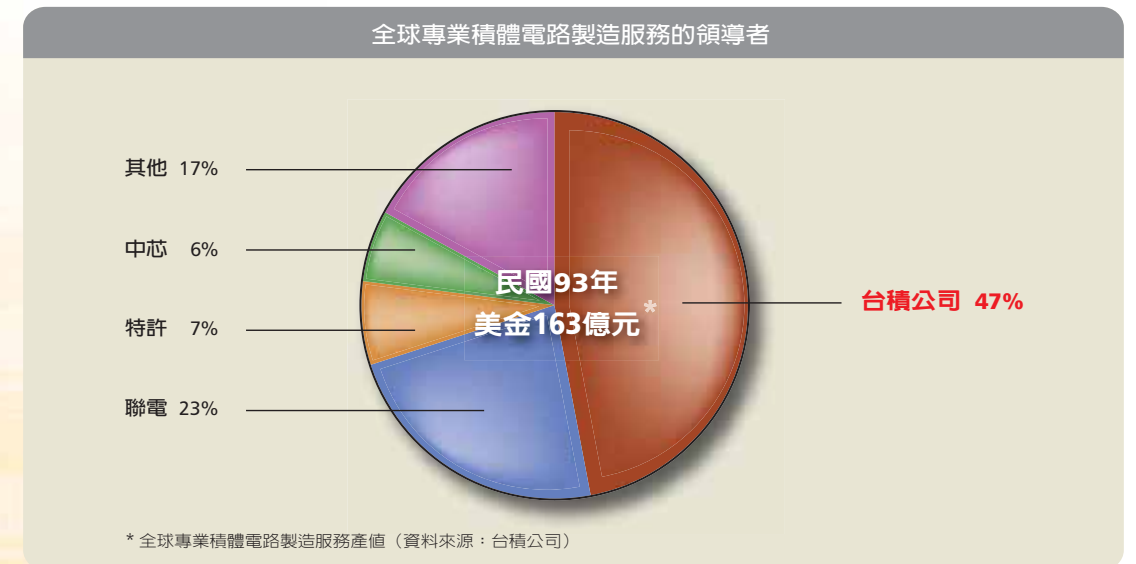
- 先進製程技術（0.13微米、0.11微米、90奈米、65奈米製程技術以及低介電質製程）
- 90奈米、65奈米絕緣層上覆矽（SOI）製程技術
- 90奈米（含）以下浸潤式微影（Immersion Lithography）製程技術
- 混合信號及射頻（MS/RF）製程技術
- 90奈米高密度嵌入式記憶體製程技術
- 0.35 微米及0.25微米邏輯製程非揮發性嵌入式記憶體製程技術
- 0.18微米、40伏特高壓製程技術
- 台積公司設計參考流程5.0版（Reference Flow 5.0），包括了電源管理及電路封裝整合設計
- 光罩服務
- 後段服務，包括台積公司自有晶圓廠內的覆晶凸塊製程及測試服務



台積公司的光罩部門是全球最具規模的光罩廠之一。

成功的準則

台積公司是全球十大積體電路公司之一。民國九十三年，台積公司在專業積體電路製造服務領域的市佔率高達47%，領先最大的競爭對手二倍之多，同時獲利率也遠高於其他競爭同業。



台積公司成功的準則在於擁有穩健的財務優勢以及強大的產能。在這些基礎上，台積公司發展出「先進技術、卓越製造、客戶夥伴關係」三位一體的競爭優勢，也強化了台積公司的領導地位以及高獲利。



先進技術

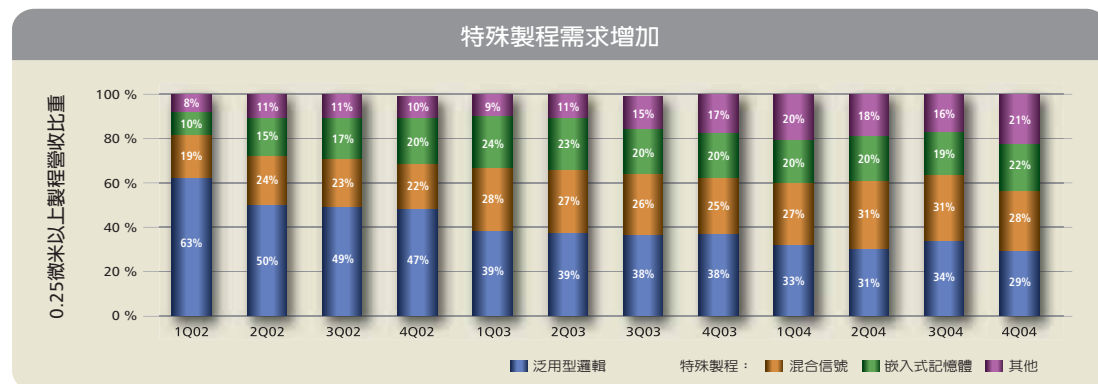
台積公司是全球半導體市場上極為重要的技術供應者，技術發展已超越了國際半導體技術發展藍圖（ITRS）。台積公司以製造及運籌管理能力為核心，充分整合前段設計及後段封裝、測試服務，達到所有客戶在商業上以及技術上的個別化需求，使得客戶因為我們優秀的製造能力、高品質的產品、快速的交貨時程以及一次購足（One-stop Service）的服務，而能夠獲得最大利潤。

在民國九十三年，台積公司是全球唯一在十二吋生產線上同時提供全銅、低介電質技術，以及90奈米製程技術的專業積體電路製造服務公司。第四季已達到每月數千片十二吋晶圓的出貨量，預期在民國九十四年將大幅加速量產時程及產能。截至民國九十三年年底，約有40個單一光罩（Single-product Mask）產品投片生產，以及30個以上的產品以共乘光罩（Mask-sharing Cybershuttle）方式進行投片生產。其中更約有10個產品已經進入量產階段，其他產品則正在進行品質驗證或設計驗證。

台積公司預期90奈米製程技術的需求在民國九十四年將在消費性產品、通訊、電腦以及其他工業用途上被廣為應用。台積公司的90奈米製程更具有高密度、高效能、低耗電以及低成本等競爭優勢，這也是客戶採用此製程技術設計晶片的主要原因。

台積公司於民國九十三年四月成功以65奈米製程技術產出靜態隨機存取記憶體（SRAM），且通過驗證。隨後，多家客戶便開始投片試產，現已成功產出多種邏輯與記憶體晶片，並進行驗證。針對客戶需求，台積公司計畫於九十四年底始，提供低功率（Low Power）的65奈米製程量產服務，而高速型（High Performance）及泛用型（General Purpose）的製程技術也將於明年依序推出；絕緣層上覆矽（SOI）以及超高速（Ultra-High Performance）製程技術則預計於民國九十六年推出。所有不同產品應用的製程都將同時提供邏輯以及混合信號製程，也可以搭配嵌入式記憶體製程技術。

台積公司不斷在先進技術上保持領先，並且藉由差異化的專業技術組合，持續在主流技術平台上拓展混合信號、嵌入式高密度記憶體、非揮發性記憶體、高電壓、以及互補式金氧半導體影像感測器等特殊製程技術。採用台積公司特殊技術的客戶，一直穩定的增加，包括混合信號、嵌入式記憶體等特殊製程對0.25微米及較成熟製程的營收的比重，從民國九十一年第一季的37%上升到民國九十三年第三季的71%。



卓越製造

在民國九十三年，台積公司提供給所有客戶約480萬片八吋晶圓（約當量），相當於全球積體電路產量的7%，全球排名在英特爾（Intel）、三星（Samsung）以及Hynix三家公司之後。台積公司的生產效能充分展現在龐大的客戶數量以及多樣的產品上。民國九十三年，台積公司擁有三百位以上的客戶，同時生產超過五千個不同的產品。此外，台積公司的生產效能也展現在產品擁有高良率以及更短的生產週期，不同廠區之間能以高度彈性互相支援不同的客戶、多樣化的產品以及不同的製程。

無可匹敵的製造能力

- 卓越的製造能力確保產品擁有高良率及更短的生產週期
- 靈活的運籌能力能支援多樣的客戶、產品與製程

民國93年	Fab2	Fab3	Fab5	Fab6	Fab7	Fab8	Fab12
客戶	122	180	79	87	72	137	58
製程	25	37	15	21	16	34	14
產品	1,415	1,086	365	521	231	684	221
產能 (千片, 八吋晶圓約當量)	522	922	470	813	165	823	549

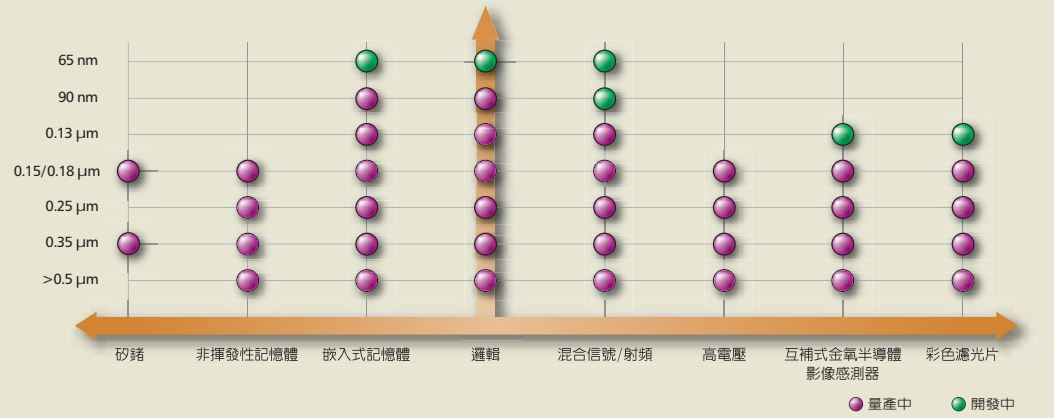
客戶夥伴關係

台積公司的營運模式建立在與積體電路設計業者的夥伴關係上。台積公司致力於與客戶建立相互信任的夥伴關係，並提供客戶實質的利益。透過台積公司最先進且完善的技術能力，客戶得以建立差異化的產品與有競爭力的成本結構。現今，在許多新積體電路設計的重要時刻，台積公司所提供的配合及服務，有助於客戶產品能夠首次生產即成功並迅速上市。

目前，台積公司提供兩個技術平台：先進技術平台及主流技術平台。先進技術平台包括位於國際半導體技術發展藍圖的最前端製程技術及嚴密的整合性服務，勾畫出半導體產業的未來技術走向。主流技術平台支援許多經過驗證的製程。客戶可以立即運用並獲致整體最大利益，這些平台將混合信號、嵌入式記憶體、非揮發性記憶體、高電壓，及互補式金氧半導體影像感測器等主要技術，及設計服務、晶片共乘、線上eFoundry創新、光罩服務及後端服務等產品服務整合。台積公司這兩個技術平台皆能滿足產業在積體電路設計廣泛應用上的需求，能使客戶的產品迅速上市、及時量產並且獲利。

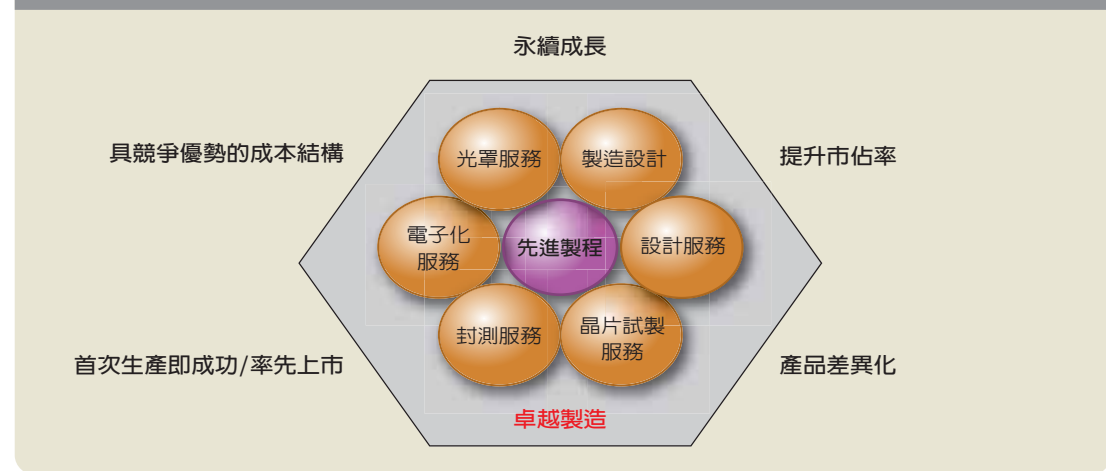
雙向延伸策略

- 從深度上看：確保先進製程技術在下一代產品應用上的領導地位
- 從廣度上看：延伸主流的技术平台到更多的特殊應用領域



台積公司致力於維持最先進技術、最具規模的專業積體電路製造服務業領導地位，相信可吸引新客戶、穩固現有客戶，同時深化客戶忠誠度與夥伴關係。

台積公司的價值



成功的專業積體電路製造服務模式

成功的專業積體電路製造服務模式除了需在尖端技術及製程效率上保持領先地位，同時也需要與客戶建立堅強的夥伴關係。

台積公司一向是主流的矽製程技術領導者，積體電路的製造效率亦是業界之先，這樣的優異表現，從我們有能力在同一時間為許多不同客戶生產各類產品，便是最佳驗證。身為專業積體電路製造服務業者，台積公司始終堅持與客戶建立堅強的夥伴關係，並為客戶提供足夠的產能與高品質的服務。透過三位一體的競爭優勢，台積公司在可預見的未來，依舊是專業積體電路製造服務領域的領導者。

公司治理

台積公司致力於維持最高標準之公司治理，堅持營運透明，並注重股東之權益。我們相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下，台積公司於民國九十一年及民國九十二年先後於董事會下成立稽核委員會及薪酬委員會。

民國九十三年，我們繼續贏得「台灣最佳公司治理」等多項獎項。我們相信好的公司治理是全球性的課題，因此我們堅持達到世界級水準的誠信與公平，並且在資訊透明與公開方面，以國際級企業為比較基準。

稽核委員會

稽核委員會旨在協助董事會執行其監督職責，審議事項包括：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度。

依稽核委員會章程規定，稽核委員會於其責任範圍內有權進行任何適當之審核及調查，其與公司內部稽核人員、簽證會計師、及所有員工間皆有直接聯繫之管道。稽核委員會也有權聘請律師、會計師或其他顧問協助其執行職務。

至民國九十四年三月底止，本公司稽核委員會共有四名委員，其中三名為獨立董事，另一名為公司之監察人。稽核委員會一年至少應召開四次常會。民國九十三年內共召開四次常會及兩次特別會議。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人、董事、監察人之報酬。

至民國九十四年三月底止，本公司薪酬委員會共有五名委員，其中三名為具有表決權之獨立董事，兩名為不具表決權之董事。薪酬委員會一年至少應召開四次常會，民國九十三年內共召開四次會議。

財務概況



 台灣積體電路製造股份有限公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

民國九十三年是我們的豐收年，
營收與獲利都再創新高紀錄。

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國八十九年至民國九十三年十二月三十一日

	九十三年 十二月三十一日	九十二年 十二月三十一日	九十一年 十二月三十一日	九十年 十二月三十一日	八十九年 十二月三十一日
資產					
流動資產					
現金及約當現金	74,302,351	102,988,896	67,790,204	37,556,295	38,840,217
短期投資－淨額	54,107,951	13,611,536	170,012	1,398,071	1,502,098
應收關係人款項	654,377	920,444	439,659	494,732	948,726
應收票據	2,942	9,893	60,240	176,582	125,175
應收帳款	31,211,481	28,495,269	19,530,702	19,957,636	30,335,314
備抵呆帳	(982,843)	(1,020,398)	(932,993)	(1,100,492)	(946,734)
備抵退貨及折讓	(3,342,450)	(2,135,843)	(2,372,515)	(2,581,551)	(2,458,323)
其他應收關係人款項	141,578	131,731	(註1)	(註1)	(註1)
其他金融資產	2,212,371	1,373,705	1,010,453	(註2)	(註2)
存貨－淨額	15,555,937	12,135,324	11,201,446	9,828,328	12,785,723
遞延所得稅資產	8,917,986	8,398,205	3,401,729	2,350,147	8,178,016
預付費用及其他流動資產	1,667,401	1,632,908	2,238,221	2,721,421	3,034,624
流動資產合計	184,449,082	166,541,670	102,537,158	70,801,169	92,344,836
長期投資	38,101,849	10,748,014	10,635,496	11,599,150	10,663,804
固定資產					
成本					
土地及土地改良物	803,508	855,394	874,907	877,371	829,239
建築物	97,882,699	79,778,533	76,428,851	60,523,505	53,874,708
機器設備	433,130,364	371,315,729	343,951,592	280,023,690	241,995,862
辦公設備	8,538,225	7,457,538	6,996,027	6,062,496	4,865,610
租賃資產	566,243	726,585	-	-	-
成本合計	540,921,039	460,133,779	428,251,377	347,487,062	301,565,419
累積折舊	(331,253,866)	(275,013,069)	(210,101,159)	(155,948,960)	(103,884,879)
預付款項及未完工程	49,244,153	26,733,553	28,348,093	59,749,530	47,067,352
固定資產淨額	258,911,326	211,854,263	246,498,311	251,287,632	244,747,892
合併商譽	7,115,510	8,720,917	10,158,845	11,437,572	11,530,973
其他資產					
遞延借項－淨額	8,992,452	7,992,016	9,873,825	3,769,750	3,335,665
遞延所得稅資產	1,649,979	1,111,367	9,773,226	16,245,828	6,629,805
存出保證金	106,448	199,522	557,266	784,089	979,067
其他	127,445	232,762	508,272	592,505	653,937
其他資產合計	10,876,324	9,535,667	20,712,589	21,392,172	11,598,474
資產總計	<u>499,454,091</u>	<u>407,400,531</u>	<u>390,542,399</u>	<u>366,517,695</u>	<u>370,885,979</u>

註1：包含於應收關係人款項

註2：包含於預付費用及其他流動資產

	九十三年 十二月三十一日	九十二年 十二月三十一日	九十一年 十二月三十一日	九十年 十二月三十一日	八十九年 十二月三十一日
負債及股東權益					
流動負債					
短期借款	383,004	407,736	729,813	6,269,181	3,833,841
應付關係人款項	2,217,815	3,248,289	1,776,149	1,048,273	2,606,339
應付帳款	7,264,419	6,438,604	5,138,592	1,397,879	8,507,827
應付工程及設備款	33,427,702	7,232,103	14,132,100	12,867,236	25,550,273
應付費用及其他流動負債	10,126,368	8,094,191	5,947,229	6,746,483	6,875,657
一年內到期之長期負債	10,500,000	5,000,000	12,107,899	5,000,000	51,055
流動負債合計	63,919,308	30,420,923	39,831,782	33,329,052	47,424,992
長期附息負債					
長期借款	1,915,020	8,800,302	11,051,454	22,399,360	23,339,367
應付公司債	19,500,000	30,000,000	35,000,000	24,000,000	29,000,000
其他長期應付款	7,964,975	3,300,829	4,281,665	-	-
其他應付關係人款項	2,317,972	-	-	-	-
應付租賃款	566,243	726,585	-	-	-
長期附息負債合計	32,264,210	42,827,716	50,333,119	46,399,360	52,339,367
其他負債					
應計退休金負債	3,101,707	2,601,450	2,211,560	1,856,617	1,511,277
存入保證金	412,881	763,889	1,395,066	7,212,688	7,086,379
未實現售後租回利益	-	-	114,928	268,165	434,183
其他	714,949	1,483,245	707,239	141,498	14,356
其他負債合計	4,229,537	4,848,584	4,428,793	9,478,968	9,046,195
少數股權	75,737	88,999	95,498	120,240	321,726
股東權益					
股本－每股面額10元					
特別股發行－					
1,300,000仟股	-	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000
普通股發行－					
九十三年23,251,964仟股，					
九十二年20,266,619仟股，					
九十一年18,622,887仟股，					
九十年16,832,554仟股，					
八十九年11,689,365仟股	232,519,637	202,666,189	186,228,867	168,325,531	116,893,646
資本公積	56,537,259	56,855,885	57,004,789	57,128,433	55,285,821
保留盈餘					
法定公積	25,528,007	20,802,137	18,641,108	17,180,067	10,689,323
特別盈餘公積	-	68,945	-	349,941	1,091,003
未分配盈餘	88,202,009	50,229,008	22,151,089	19,977,402	65,143,847
長期投資未實現跌價損失	-	(35)	(194,283)	-	-
累積災算調整數	(2,226,427)	225,408	945,129	1,228,701	(278,377)
庫藏股票(成本)－45,521仟股	(1,595,186)	(1,633,228)	(1,923,492)	-	(71,564)
股東權益合計	398,965,299	329,214,309	295,853,207	277,190,075	261,753,699
負債及股東權益總計	<u>499,454,091</u>	<u>407,400,531</u>	<u>390,542,399</u>	<u>366,517,695</u>	<u>370,885,979</u>

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併損益表

民國八十九年至民國九十三年一月一日至十二月三十一日

	九十三年度	九十二年度	九十一年度	九十年度	八十九年度
銷貨收入總額	261,947,351	207,279,137	166,187,670	128,560,708	169,192,312
銷貨退回及折讓	(4,734,733)	(4,282,325)	(3,886,462)	(2,675,816)	(2,994,708)
銷貨收入淨額	257,212,618	202,996,812	162,301,208	125,884,892	166,197,604
銷貨成本	141,393,435	128,113,334	109,988,058	92,228,098	87,609,670
銷貨毛利	115,819,183	74,883,478	52,313,150	33,656,794	78,587,934
營業費用					
研究發展費用	12,516,434	12,712,695	11,725,035	10,293,544	7,203,591
管理費用	11,454,374	8,199,965	6,767,756	8,129,980	7,408,121
行銷費用	3,366,701	2,670,237	2,231,320	2,455,473	2,681,534
營業費用合計	27,337,509	23,582,897	20,724,111	20,878,997	17,293,246
營業利益	88,481,674	51,300,581	31,589,039	12,777,797	61,294,688
營業外收入及利益					
按權益法認列之投資淨益	2,094,137	-	-	-	-
利息收入	1,858,359	888,107	1,094,724	1,486,656	1,679,736
技術權利金收入	-	-	527,126	1,301,606	524,194
處分固定資產利益	242,785	438,809	273,998	52,376	62,921
技術服務收入	423,804	209,764	162,149	55,077	138,514
處分長、短期投資淨益	914,541	3,538,081	-	1,724,501	1,076,063
保險理賠收入淨額	-	-	-	860,835	1,623,832
權利金收入淨額	-	-	-	234,732	8,115
兌換淨利	-	-	-	-	828,025
其他收入	556,598	594,551	291,860	759,793	178,403
合計	6,090,224	5,669,312	2,349,857	6,475,576	6,119,803

	九十三年度	九十二年度	九十一年度	九十年度	八十九年度
營業外費用及損失					
利息費用	1,528,908	1,891,009	2,616,740	3,144,042	2,717,035
按權益法認列之投資淨損	-	294,244	1,976,847	3,959,020	187,179
長期投資已實現跌價損失	350,608	652,718	795,674	-	-
處分及提列固定資產及閒置資產損失	131,148	1,880,325	466,385	235,629	114,768
權利金費用淨額	-	153,783	419,513	-	-
處分長、短期投資淨損	-	-	101,221	-	-
兌換淨損	382,164	755,100	120,568	695,620	-
短期投資跌價損失	75,212	-	-	-	-
災害損失淨額	-	-	119,485	-	-
其他損失	138,271	164,069	100,315	432,557	493,985
合計	2,606,311	5,791,248	6,716,748	8,466,868	3,512,967
稅前綜合利益	91,965,587	51,178,645	27,222,148	10,786,505	63,901,524
所得稅利益(費用)	363,426	(3,922,957)	(5,636,648)	3,740,678	1,167,884
綜合純益	92,329,013	47,255,688	21,585,500	14,527,183	65,069,408
少數股權損失(利益)	(12,898)	3,012	24,791	(44,009)	36,786
合併純益	92,316,115	47,258,700	21,610,291	14,483,174	65,106,194
合併每股盈餘(註)					
基本每股盈餘	3.97	2.02	0.91	0.60	2.85
稀釋每股盈餘	3.97	2.02	0.91	0.60	2.85

註：按盈餘轉增資及員工紅利配股比例追溯調整後之每股盈餘

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國八十九年至民國九十三年一月一日至十二月三十一日

	九十三年度	九十二年度	九十一年度	九十年度	八十九年度
營業活動之現金流量					
合併純益	92,316,115	47,258,700	21,610,291	14,483,174	65,106,194
折舊及攤銷	69,818,457	69,161,317	65,000,873	55,323,040	41,446,137
遞延所得稅	(1,058,393)	3,665,383	5,421,020	(3,788,154)	(956,118)
按權益法認列之投資淨損(益)	(2,094,137)	294,244	1,976,847	3,959,020	187,179
長期債券投資溢折價攤銷	28,673	-	-	-	-
長期投資已實現跌價損失	350,608	652,718	795,674	-	-
處分長期投資淨損(益)	(85,203)	(78,694)	170,831	(105,439)	(15,144)
處分及提列固定資產及閒置資產損失	(111,637)	1,441,516	192,387	183,253	51,847
迴轉未實現短期投資跌價損失	-	-	-	(13,146)	-
提列退休金費用	500,257	389,890	355,705	345,340	370,276
少數股權淨利(淨損)	12,898	(3,012)	(24,791)	44,009	(36,786)
營業資產及負債之淨變動					
應收關係人款項	266,067	(612,516)	55,073	453,994	(737,105)
應收票據	6,951	50,347	116,342	(51,407)	38,959
應收帳款	(2,716,212)	(8,964,567)	426,934	10,377,678	(15,467,155)
備抵呆帳	(37,555)	87,405	(167,499)	153,758	524,532
備抵退貨及折讓	1,206,607	(236,672)	(209,036)	123,228	1,679,309
存貨	(3,420,613)	(933,878)	(1,373,118)	2,957,395	(4,033,836)
預付費用及其他流動資產(包含其他應收關係人款項及其他金融資產)	(821,440)	257,840	(493,461)	251,783	238,258
應付關係人款項	(1,499,968)	1,472,140	727,876	(1,558,066)	2,334,247
應付票據	-	-	-	-	(4,303)
應付所得稅	-	-	-	-	(151,828)
應付帳款	825,815	1,300,012	3,740,713	(7,109,948)	3,174,958
應付費用及其他流動負債	(336,385)	834,941	184,564	(211,800)	1,036,576
營業活動之淨現金流入	153,150,905	116,037,114	98,507,225	75,817,712	94,786,197
投資活動之現金流量					
短期投資減少(增加)	(43,554,878)	(13,326,339)	1,184,419	117,173	(524,154)
質押定存減少	-	-	-	-	3,161,693
長期投資增加	(23,054,379)	(1,412,335)	(3,192,427)	(5,120,580)	(2,956,758)
購置固定資產	(81,094,557)	(37,870,907)	(55,235,458)	(70,201,205)	(103,761,905)
處分長期投資價款	165,243	505,702	53,048	559,137	49,376
處分固定資產價款	1,812,633	177,312	495,878	301,416	364,875
遞延借項增加	(2,405,673)	(2,138,087)	(5,724,583)	(1,805,250)	(1,793,209)
存出保證金減少(增加)	93,074	357,744	226,823	194,978	(915,559)
其他資產減少(增加)	51,604	4,610	2,711	(9,162)	77,451
少數股權增加(減少)	(26,160)	(3,487)	49	(249,166)	(7,165,656)
商譽增加	-	-	-	(1,019,227)	(8,221,266)
合併德基公司之現金流入	-	-	-	-	736,594
投資活動之淨現金流出	(148,013,093)	(53,705,787)	(62,189,540)	(77,231,886)	(120,948,518)

	九十三年度	九十二年度	九十一年度	九十年度	八十九年度
融資活動之現金流量					
普通現金股利	(12,137,190)	-	-	-	-
買回庫藏股	(7,059,798)	-	-	-	-
短期借款增加(減少)	-	(309,807)	(5,539,368)	2,435,340	(8,592,790)
應付公司債增加(減少)	(5,000,000)	(4,000,000)	10,000,000	-	9,000,000
發行普通股	-	-	-	-	39,204,525
員工行使認股權發行新股	3,624	-	-	-	-
處分庫藏股	39,906	300,284	-	-	-
應付商業本票減少	-	-	-	-	(4,241,048)
長期借款增加(減少)	(6,656,152)	(8,915,557)	(4,397,306)	(940,007)	(2,648,853)
員工現金紅利	(681,628)	-	-	-	-
存入保證金增加(減少)	(351,008)	(631,177)	(5,817,622)	126,309	2,978,984
應付租賃款減少	-	-	-	(51,286)	(1,052)
特別股現金股利	(184,493)	(455,000)	(455,000)	(455,000)	(215,151)
特別股贖回	-	(13,000,000)	-	-	-
董監事酬勞	(127,805)	(58,485)	(133,848)	(170,440)	-
融資發行成本增加	-	-	(3,002)	(47,689)	(118,335)
融資活動之淨現金流入(出)	(32,154,544)	(27,069,742)	(6,346,146)	897,227	35,366,280
現金及約當現金淨增加	(27,016,732)	35,261,585	29,971,539	(516,947)	9,203,959
匯率影響數	(1,669,813)	(62,893)	262,370	(766,975)	118,576
年初現金及約當現金餘額	102,988,896	67,790,204	37,556,295	38,840,217	29,517,682
年底現金及約當現金餘額	74,302,351	102,988,896	67,790,204	37,556,295	38,840,217
現金流量資訊之補充揭露					
支付利息(不含資本化利息)	1,470,333	1,982,594	2,301,765	3,468,112	4,036,210
支付所得稅	389,189	218,954	165,121	20,767	96,523
不影響現金流量之投資及融資活動					
子公司持有母公司股票自長期投資重分類為庫藏股	-	-	1,923,492	-	-
一年內到期之長期負債	10,500,000	5,000,000	12,107,899	5,001,116	51,055
一年內到期之其他應付關係人款項(帳列應付關係人款項)	492,022	-	-	-	-
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付費用及其他流動負債)	1,505,345	1,591,972	1,157,299	-	-
長期投資轉列短期投資	343,950	140,984	-	-	-
短期投資轉列長期投資	3,402,413	-	-	-	-

台積公司主要辦事處

公司本部及晶圓十二廠

300-77新竹科學工業園區力行六路8號
電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5637000

晶圓二廠、五廠

300-77新竹科學工業園區區三路121號
電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5781546

晶圓三廠

300-77新竹科學工業園區研新一路9號
電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5781548

晶圓六廠

741-44台南科學工業園區南科北路1號
電話：886-6-5059688 傳真：886-6-5052057

晶圓七廠

300-77新竹科學工業園區研新二路6號
電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5773628

晶圓八廠

300-77新竹科學工業園區力行路25號
電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5662051

晶圓十四廠

741-44台南科學工業園區南科北路1號之1
電話：886-6-5059688 傳真：886-6-5051262

美國子公司

2585 Junction Avenue
San Jose, CA 95134, U.S.A.
電話：408-3828000 傳真：408-3828008

歐洲子公司

World Trade Center, Strawinskylaan 1145
1077 XX Amsterdam, The Netherlands
電話：31-20-3059900 傳真：31-20-3059911

日本子公司

21F, Queen's Tower C, 2-3-5, Minato Mirai
Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-6221, Japan
電話：81-45-6820670 傳真：81-45-6820673

台積電（上海）有限公司

上海松江區文翔路4000號
郵政編碼：201616
電話：86-21-57768000 傳真：86-21-57762525

台積公司法人關係處

電子信箱：invest@tsmc.com

簽證會計師

事務所名稱：勤業眾信會計師事務所
會計師姓名：黃鴻文、張銘政
105 台北市民生東路三段156號12樓
電話：886-2-25459988 傳真：886-2-25459966
網址：http://www.deloitte.com.tw

辦理股票過戶機構

中國信託商業銀行法人信託作業客服部
100 台北市重慶南路一段83號5樓
電話：886-2-23613033 傳真：886-2-23116723
網址：http://www.chinatrust.com.tw

美國存託憑證（ADR）存託銀行

Citibank, N.A.
Depositary Receipts Services
388 Greenwich Street
New York, NY10013, U.S.A.
網址：http://www.citibank.com/adr
Toll Free: 1-877-24484237
Outside USA: 1-816-8434281
Fax: 1-201-3243284
Email: citibank@shareholders-online.com

本公司的美國存託憑證（ADR）在美國紐約證券交易所（NYSE）以TSM為代號掛牌交易。查詢海外有價證券資訊之方式：http://www.nyse.com以及http://newmops.tse.com.tw

Safe Harbor Notice

The statements included in this document that are not historical in nature are "forward-looking statements" within the meaning of the "safe harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. TSMC cautions readers that forward-looking statements are subject to significant risks and uncertainties and are based on TSMC's current expectations. Actual results may differ materially from those contained in such forward-looking statements for a variety of reasons including, among others, risks associated with cyclicity and market conditions in the semiconductor industry; demand and supply for TSMC's foundry manufacturing capacity in particular and for foundry manufacturing capacity in general; intense competition; the failure of one or more significant customers to continue to place the same level of orders with us; TSMC's ability to remain a technological leader in the semiconductor industry; TSMC's ability to manage its capacity; TSMC's ability to obtain, preserve and defend its intellectual property rights; natural disasters and other unexpected events which may disrupt production; and exchange rate fluctuations. Additional information as to these and other risk factors that may cause TSMC's actual results to differ materially from TSMC's forward-looking statements may be found in TSMC's Annual Report on Form 20-F, filed with the United States Securities and Exchange Commission (the "SEC" on May 28, 2004, and such other documents as TSMC may file with, or submit to, the SEC from time to time. Except as required by law, we undertake no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.